

2018年5月吉日

総額5億円でのシリーズ A ラウンド資金調達を完了

この度、AI や画像処理の半導体回路およびソフトウェアを開発する ArchiTek 株式会社(本社: 大阪市、代表取締役: 高田周一、以下アーキテック)は、第三者割当増資を実施し、総額5億円のシリーズ A ラウンドの資金調達を完了いたしましたので、お知らせいたします。

本ラウンドにおける引受先として、本年3月6日発表の未来創生ファンドに加え、本日新たに合同会社テックアクセルベンチャーズ、株式会社 NTTドコモ・ベンチャーズ、三菱 UFJ キャピタル株式会社、池田泉州キャピタル株式会社が加わりました。これによりアーキテックの資金調達額はこれまでを含め、累計で約5億3千万円となりました。

【シリーズ A 資金調達引受先】

未来創生ファンド	運営者: スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長 阿部修平
合同会社テックアクセルベンチャーズ(※)	本社: 東京都港区 職務執行者 安岡伸浩
株式会社 NTTドコモ・ベンチャーズ(※)	本社: 東京都港区 代表取締役社長 中山俊樹
三菱 UFJ キャピタル株式会社(※)	本社: 東京都中央区 代表取締役社長 半田宗樹
池田泉州キャピタル株式会社(※)	本社: 大阪市北区 代表取締役社長 石飛光俊

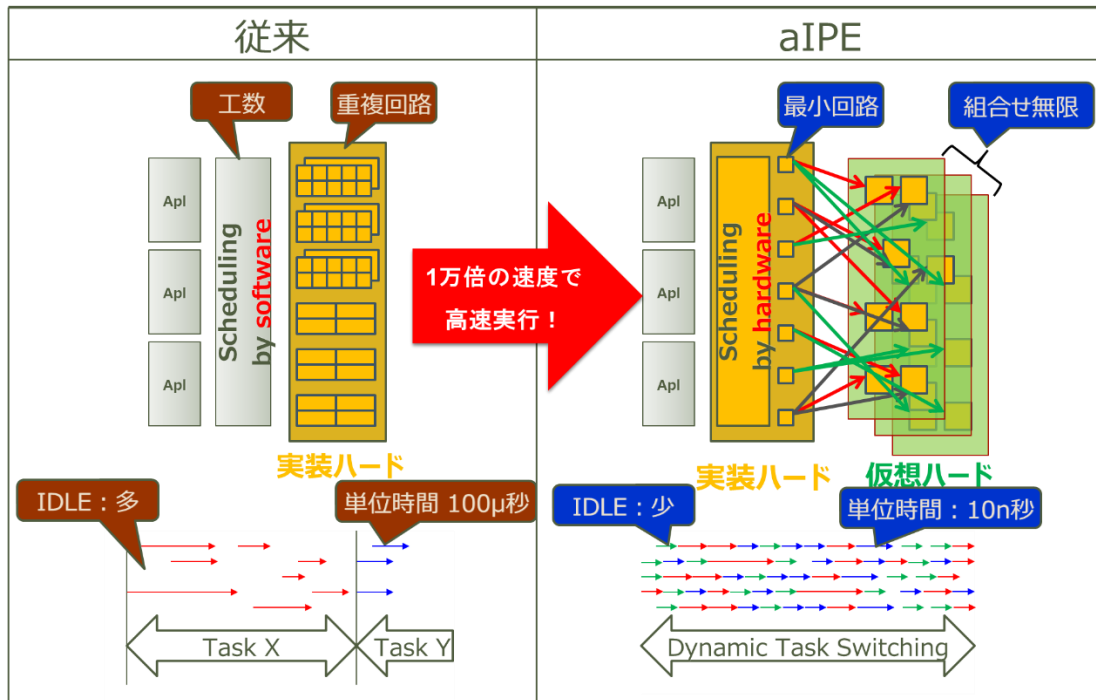
(※)各社が運営するファンドにて引受

今回の資金調達は、当社が独自開発した高速かつ低消費電力の半導体回路と、その上で動作する各種アルゴリズムの開発に充当するとともに、量産化に向けた基盤や体制を強化していく予定です。

【アーキテックについて】

- ・会社名 ArchiTek 株式会社 (<http://www.architek.co.jp>)
- ・本社 大阪市阿倍野区北畠2丁目3番24号
- ・オフィス 大阪市西区北堀江1丁目1番7号303
- ・代表者 代表取締役 高田周一
- ・事業内容 アーキテクチャ開発、LSI 開発、ソフトウェア開発

当社は、独自開発したアーキテクチャの IP コアおよび LSI 設計ノウハウを用いて、高度な映像解析や Deep Learning 等の AI を活用した画像認識のアプリケーションを高速かつ低消費電力で実現する LSI を開発しております。この技術は、IoT デバイス等のエッジコンピューティングでの活用のみならず、より幅広い領域に活用する事ができるものと期待されています。



【本件に関するお問い合わせ】
 ArchiTek 株式会社 取締役 CFO 藤中
 Mail: pico@architek.co.jp